

檔號：SC20199
保存年限：3

國立中興大學 函

地址：臺中市南區40227國光路250號
聯絡人：林嘉玲
聯絡電話：04-22858068
傳真：04-2285-5507
電子信箱：cl.lin@dragon.nchu.edu.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國103年10月1日
發文字號：興進字第1030900513號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（10309005130-1.DOC，共1個電子檔案）

主旨：檢送本校辦理臺灣中部科學園區產學訓協會「2014半導體製程設計與先進設備專題競賽」，歡迎貴校師生踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、旨揭專題競賽報名方式及活動地點如下：

- (一)競賽日期：103年10月30日(星期四)
- (二)活動地點：國立中興大學雲平樓F12階梯教室
- (三)報名方式：請填寫參賽報名表及參賽報告書，寄至承辦人信箱clinnchu@gmail.com，報告書採用PDF或WORD格式，單檔請勿超過6MB，如有特殊情況請與承辦人聯繫，聯絡電話：04-2285-5506 林小姐。
- (四)活動網址：http://nchu.cc/6b!FM

正本：公私立大專校院
副本：本校企劃行銷組

103/10/01
11:46:42

擬定：
一、公告訂定公告系統
二、專和國際系

約用助理員 蔡蕙如

教授兼科技學院院長 張振豪
1006

秘書室 宋守中
專門委員
1007

秘書室 宋守中
1007

臺灣中部科學園區產學訓協會

「2014 半導體製程設計與先進設備專題競賽」比賽辦法

一、活動目的：

半導體光電產業在全球市場中佔有重要的地位，要持續提昇我國半導體光電產業的競爭力，建立製程設備自主能力將是一個有效的方法。本活動為推動台灣半導體光電產業設備的發展，透過辦理半導體製程流程系統設計專題競賽，激發學生潛力，培養學生具有創新、設計、整合及實作之能力。並藉由活動增進學生對產業設備的認知及技術交流，促進產學合作，為產業持續培育人才、創造產值。

二、籌辦單位：

指導單位：科技部中部科學工業園區管理局、臺灣中部科學園區產學訓協會

主辦單位：國立中興大學創新產業推廣學院、先端產業暨精密製程中心

三、競賽日期與地點：

日期：103年10月30日(星期四)

地點：國立中興大學雲平樓(臺中市南區國光路250號)

四、參賽資格：

(1) 以全國公私立大專院校之全職在學學生為參賽對象(應屆畢業生得以參加)。

(2) 隊伍由2-5位學生組成，每隊需選定一名代表人。

五、競賽內容：

競賽將針對智慧型半導體光電製程設備或系統進行專題研究，參賽隊伍宜選擇符合前述相關訴求，且具有實際成果之研究，自訂專題競賽之主題。

(1) 產業涵蓋範圍：PCB電路板、半導體晶片、液晶顯示器面板、太陽能電池晶片、LED發光二極體等半導體光電元件製程之設備。

(2) 製程設備涵蓋範圍：晶錠(柱)之生長、微影技術、沈積蝕刻、切割封裝、檢測等所有相關製程所需之設備，如曝光對準機、化學/物理氣相沉積、乾溼蝕刻、雷射切割、封裝打線、自動化光學檢測系統等設備。

(3) 研究對象可為設備之模組、系統或其應用整合，或關鍵零組件/模組之模擬、設計、製造或控制；也可以是設備或產線之製程、監控或檢測之自動化、人機介面、電路設計、智慧自動化設計、系統整合等相關技術研究。

(4) 決賽內容為實體作品(含示意模型)展示及實地口頭報告說明。由主辦單位提供每參賽隊伍一個展示攤位，各隊需準備8-10分鐘實地口頭報告說明(含評審提問)，解說作品內容及進行必要之操作，得以簡報、海報及多媒體等方式輔助說明，以利評審委員與參觀人員了解。

六、競賽時程表：

賽程	日期	事項說明	備註
辦法公布	即日起	主辦單位公告競賽辦法，敬邀國內團隊參加	請至創新產業推廣學院網站下載相關表格
活動報名	即日起至103年10月17日截止	請有意參賽之隊伍於截止日前回傳報名表	請email至承辦人信箱 clinnchu@gmail.com
報名隊伍「參賽報告書」繳交	即日起至103年10月17日截止	請以email附件方式繳交「參賽報告書」	請以email至承辦人信箱 clinnchu@gmail.com ，報告書採用PDF格式，單檔請勿超過6MB，如有特殊情況請與承辦人聯繫
決賽暨頒獎	103年10月30日	參賽隊伍於展示會場進行成果報告及作品展示，由專家組成評審委員會依評審標準決定名次	地點：國立中興大學雲平樓現場公布決賽結果與頒獎

七、獎勵辦法：

- (1) 第一名：計1隊，頒發獎狀一張及新臺幣參萬元整。
- (2) 第二名：計1隊，頒發獎狀一張及新臺幣壹萬貳仟元整
- (3) 第三名：計1隊，頒發獎狀一張及新臺幣捌仟元整。
- (4) 佳作獎：計2隊，頒發獎狀一張及新台幣伍仟元整。
- (6) 入圍並參與決賽之隊伍，將頒予入圍證書，以資鼓勵。

八、競賽方式：

- (1) 決賽內容為實體作品(含示意模型)展示及實地口頭報告說明，各隊需準備8-10分鐘實地口頭報告說明(含評審提問)，解說作品內容及進行必要之操作，得以簡報、海報(至多2張)及多媒體等方式輔助說明，以利評審委員與參觀人員了解。
- (2) 主辦單位將提供每一參賽隊伍一個展示攤位，提供之設備包括：海報展示板(160cmx90cm)2面；展示桌1張(180cmx60cm)、椅子等。

九、評審方式：

- (1) 本競賽評選分為初審與決賽兩階段，由中心邀請來自產學研等專家組成評審委員會，辦理評選作業。決賽日期為103年10月30日(四) (當日議程主辦單位將另行公佈)，決賽內容為實體作品展示及實地口頭報告說明。
- (2) 決賽評審標準：

評分項目	項目說明	評分配比
創意及前瞻性	內容之創新、創意性或前瞻性。	20%
實用性	具有可實現性、實用性、或商品化可行性。	20%
預期效益	作品對產業或學術之影響力。	20%
資料完備性	內容完整性及正確性，包含文獻回顧、設計原理分析、參賽團隊分工合作方式、成果及預期結果等，以及其他有利之補充資料。	20%
報告與展示	包含報告技巧、人員表達能力及作品呈現效果(實體、示意模型、簡報、海報或多媒體等)進行評分。	20%

十、報名規則：

- (1) 報名參賽隊伍請於103年10月17日前將報名表(附件一)以及作品構想書(附件二)E-mail回傳至中心承辦人信箱報名(clinnchu@gmail.com)，若兩天內未收到報名成功確認信，請與承辦人聯絡。
- (2) 入圍決賽之隊伍需於103年10月17日前繳交「參賽報告書」(附件三)。
- (3) 相關注意事項，請詳閱「創新產業推廣學院」網站之「2014半導體製程設計與先進設備專題競賽」網頁<http://www.siil.nchu.edu.tw>。

十一、其他注意事項：

- (1) 參賽作品之智慧財產權屬參賽團隊所有，因參賽所衍生之智慧財產保護事宜，由參賽團隊自行處理。
- (2) 參賽團隊成員資料若查有不實者，主辦單位可隨時取消其競賽資格。參賽團隊成員經提報後若有變更，須送交書面資料經主辦單位審查同意。
- (3) 入圍作品如有仿冒抄襲或違反本競賽相關規定等，經查證屬實者，將追回資格與獎勵，並由參賽者自負法律責任。
- (4) 主辦單位得自由免費運用參賽作品之照片、幻燈片及說明文字等相關資料，作為教育相關之展覽、宣傳及出版等用途。
- (5) 本作業須知未盡事宜，主辦單位保留隨時解釋、修正內容之權利。

其他未盡事項請逕詢學院網站之競賽網頁：<http://www.siil.nchu.edu.tw>
或 電洽 (04)2285-5505、6 王小姐或林小姐

臺灣中部科學園區產學訓協會

「2014 半導體製程設計與先進設備專題競賽」競賽報名表

參賽主題			
校名系所			
指導老師			
E-mail		聯絡電話	
隊長 (總聯絡人)	姓名		聯絡電話
	E-mail		
團隊成員	姓名		聯絡電話
	E-mail		
	姓名		聯絡電話
	E-mail		
	姓名		聯絡電話
	E-mail		
	姓名		聯絡電話
	E-mail		
注意事項	<p>1.請於103年10月17日前填妥報名表傳真或E-mail至報名窗口(聯絡人),經核對基本資料後,將另行通知是否完成報名,主辦單位保留核准與否之權利。</p> <p>2.若為跨校、系團隊,請於校名系所欄中全部填入</p> <p>聯絡人:林嘉玲 E-mail: clinnchu@gmail.com 聯絡電話:(04)2285-5505、6 FAX:(04)2285-5507</p>		

【附件二】

臺灣中部科學園區產學訓協會

「2014半導體製程設計與先進設備專題競賽」

<競賽題目：□□□□□>

構想書

◆指導老師：_____

◆參賽隊員：_____（隊長）

◆學校名稱：_____

◆科系所：_____

目次

(請依此格式撰寫，內文建議以不超過五頁為原則，12號字單行間距)

1.摘要

(含作品簡介、創新性與功能性等概要敘述)

2.設計原理

(作品之設計原理、理論依據等)

3.作品說明

(含軟硬體架構、運作方法、預期效用等圖文說明)

4.作品優勢

(本作品之創新性與應用性等，凡可突顯作品優點者，皆屬此類)

5.結論

6.參考文獻

【附件三】

臺灣中部科學園區產學訓協會
「2014 半導體製程設計與先進設備專題競賽」

《參賽報告書撰寫格式》

一、內容格式：

依序為封面、作品簡介、參賽照片、報告內容、專題製作心得。

(一)報告封面 (p.1)

(二)作品簡介 (p.2)

(三)參賽照片 (p.3)

(四)報告內容 (p.4)：請包括摘要、前言、文獻探討、設計原理分析、參賽團隊分工合作方式、成果及預期結果、結論、參考文獻、附件等，本格式說明僅為統一成果報告之格式，以供撰寫之參考，並非限制研究成果之呈現方式，並以 10 頁之內為原則(含目錄、參考文獻及附件)。

(五)專題製作心得 (p.5)

(六)頁碼編寫：從目錄下一頁開始以阿拉伯數字 1.2.3.....順序標在每頁下方中央。

二、打字編印注意事項：

(一)用紙：

使用 A4 紙，即長 29.7 公分，寬 21 公分。

(二)格式：

中文打字規格為每行繕打，固定行高 20pt，行間不另留間距；英文打字規格為 Single Space。

(三)字體：

報告之正文以中英文撰寫均可。在字體之使用方面，英文使用 Times New Roman Font，中文使用標楷體，字體大小請以 12 號為主。

三、報名參賽之隊伍請於 103 年 10 月 17 日前將參賽報告書 email 至承辦人信箱 clinnchu@gmail.com，報告書採用 PDF 或 WORD 格式，單檔請勿超過 6MB，如有特殊情況請與承辦人聯繫。(檔案轉成 PDF 檔時，請注意圖片解析度需清晰，圖片勿模糊不清，謝謝！)

「2014 半導體製程設計與先進設備專題競賽」

參賽報告書

題目：_____

參賽編號：(主辦單位填寫)

學校系所：_____

指導老師：_____

參賽成員：_____ (隊長)

中華民國_____年_____月_____日

簡 介

請勿更改此版面格式、標題，以利大會後續排版事宜!內容不要超過 1 頁。(可刪除此段說明後直接進行撰寫，謝謝。)

臺灣中部科學園區產學訓協會

「2014 半導體製程設計與先進設備專題競賽」

參賽照片

1. 團隊隊員照片(1 張)
2. 參賽作品照片(至多 2 張)

目 錄

請依規定格式：中文為標楷體，英文、數字皆為 Times New Roman，12 號字，固定行高 20pt，段落間距前、後段各 0 行撰寫報告，總頁數(包含此目錄頁)以不超過 10 頁為限。(可刪除此段說明後直接進行撰寫，謝謝。)

- 一. 摘要
- 二. 前言與文獻回顧
- 三. 設計原理分析
- 四. 參賽團隊分工合作方式
- 五. 成果及預期結果
- 六. 結論
- 七. 參考文獻
- 八. 附件

「2014 半導體製程設計與先進設備專題競賽」

專題製作心得

請勿更改此版面格式、標題，以利大會後續排版事宜!內容不要超過1頁。(可刪除此段說明後直接進行撰寫，